



2025-2031中国FC-CSP市场现状研究分析与发展前景预测报告

【行业】:电子及半导体 【报告编码】:176526201443347

【出版时间】:2025-12-09 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

内容摘要

据最新调研，2024年中国FC-CSP市场销售收入达到了 万元，预计2031年可以达到 万元，2025-2031期间年复合增长率(CAGR)为 %。

本文研究中国市场FC-CSP现状及未来发展趋势，侧重分析在中国市场扮演重要角色的企业，重点呈现这些企业在中国市场的FC-CSP收入、市场份额、市场定位、发展计划、产品及服务等。历史数据为2020至2025年，预测数据为2026至2031年。本研究项目旨在梳理FC-CSP领域产品系列，洞悉行业特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断FC-CSP领域内各类竞争者所处地位。

FC-CSP是芯片级尺寸封装形式，根据J-STD-012标准，封装体尺寸不超过裸芯片1.2倍。其通过凸块与基板倒装焊实现电气互连，芯片面朝下直接贴合基板，相比传统打线封装（WB）和载带自动键合（TAB），信号路径更短、I/O密度更高，尤其适合大规模集成电路（LSI）、超大规模集成电路（VLSI）及专用集成电路（ASIC）。典型应用包括智能手机处理器、服务器内存模块及高密度射频芯片，核心优势在于小型化、低功耗与高性能集成。

中国市场核心厂商包括ASE Group、Samsung、Amkor、JECT、SPIL等，2024年前三大厂商，占有大约 %的市场份额。从产品产品类型方面来看，单芯片FC-CSP占有重要地位，预计2031年份额将达到 %。同时就应用来看，移动设备AP在2024年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

主要企业包括：

ASE Group
Samsung
Amkor
JECT
SPIL
Powertech Technology Inc
TSHT
TFME
UTAC
Chipbond
ChipMOS
KYEK
Unisem
Walton Advanced Engineering
Signetics
Hana Micron
NEPES

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

单芯片FC-CSP
多芯片平置FC-CSP
叠层芯片混联FC-CSP

按照不同技术，包括如下几个类别：

凸块技术
基板技术
塑封技术

按照不同工艺，包括如下几个类别：

焊锡凸块
混合键合

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

移动设备AP
基带芯片
其他

本文正文共8章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模及增长率，2020-2031年

第2章：中国市场FC-CSP主要企业竞争分析，主要包括FC-CSP收入、市场占有率、及行业集中度等

第3章：中国市场FC-CSP主要企业基本情况介绍，包括公司简介、FC-CSP产品、FC-CSP收入及最新动态等

第4章：中国不同产品类型FC-CSP规模及份额等

第5章：中国不同应用FC-CSP规模及份额等

第6章：行业发展环境分析

第7章：行业供应链分析

第8章：报告结论

本报告的关键问题

市场空间：中国FC-CSP行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？

产业链情况：中国FC-CSP厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？

厂商分析：全球FC-CSP领先企业是谁？企业情况怎样？

报告目录

1 FC-CSP市场概述

1.1 FC-CSP市场概述

1.2 不同产品类型FC-CSP分析

1.2.1 中国市场不同产品类型FC-CSP规模对比（2020 VS 2024 VS 2031）

1.2.2 单芯片FC-CSP

1.2.3 多芯片平置FC-CSP

1.2.4 叠层芯片混联FC-CSP

1.3 不同技术FC-CSP分析

1.3.1 中国市场不同技术FC-CSP规模对比（2020 VS 2024 VS 2031）

1.3.2 凸块技术

1.3.3 基板技术

1.3.4 塑封技术

1.4 不同工艺FC-CSP分析

1.4.1 中国市场不同工艺FC-CSP规模对比（2020 VS 2024 VS 2031）

1.4.2 焊锡凸块

1.4.3 混合键合

1.5 从不同应用，FC-CSP主要包括如下几个方面

1.5.1 中国市场不同应用FC-CSP规模对比（2020 VS 2024 VS 2031）

1.5.2 移动设备AP

1.5.3 基带芯片

1.5.4 其他

1.6 中国FC-CSP市场规模现状及未来趋势（2020-2031）

2 中国市场主要企业分析

2.1 中国市场主要企业FC-CSP规模及市场份额

2.2 中国市场主要企业总部及主要市场区域

2.3 中国市场主要厂商进入FC-CSP行业时间点

2.4 中国市场主要厂商FC-CSP产品类型及应用

2.5 FC-CSP行业集中度、竞争程度分析

2.5.1 FC-CSP行业集中度分析：2024年中国市场Top 5厂商市场份额

2.5.2 中国市场FC-CSP第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

2.6 新增投资及市场并购活动

3 主要企业简介

3.1 ASE Group

3.1.1 ASE Group公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.1.2 ASE Group FC-CSP产品及服务介绍

3.1.3 ASE Group在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.1.4 ASE Group公司简介及主要业务

3.2 Samsung

3.2.1 Samsung公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.2.2 Samsung FC-CSP产品及服务介绍

3.2.3 Samsung在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.2.4 Samsung公司简介及主要业务

3.3 Amkor

3.3.1 Amkor公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.3.2 Amkor FC-CSP产品及服务介绍

3.3.3 Amkor在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.3.4 Amkor公司简介及主要业务

3.4 JECT

3.4.1 JECT公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.4.2 JECT FC-CSP产品及服务介绍

3.4.3 JECT在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.4.4 JECT公司简介及主要业务

3.5 SPIL

3.5.1 SPIL公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.5.2 SPIL FC-CSP产品及服务介绍

3.5.3 SPIL在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.5.4 SPIL公司简介及主要业务

3.6 Powertech Technology Inc

3.6.1 Powertech Technology Inc公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.6.2 Powertech Technology Inc FC-CSP产品及服务介绍

3.6.3 Powertech Technology Inc在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.6.4 Powertech Technology Inc公司简介及主要业务

3.7 TSHT

3.7.1 TSHT公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.7.2 TSHT FC-CSP产品及服务介绍

3.7.3 TSHT在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.7.4 TSHT公司简介及主要业务

3.8 TFME

3.8.1 TFME公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.8.2 TFME FC-CSP产品及服务介绍

3.8.3 TFME在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.8.4 TFME公司简介及主要业务

3.9 UTAC

3.9.1 UTAC公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.9.2 UTAC FC-CSP产品及服务介绍

3.9.3 UTAC在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.9.4 UTAC公司简介及主要业务

3.10 Chipbond

3.10.1 Chipbond公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.10.2 Chipbond FC-CSP产品及服务介绍

3.10.3 Chipbond在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.10.4 Chipbond公司简介及主要业务

3.11 ChipMOS

3.11.1 ChipMOS公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

3.11.2 ChipMOS FC-CSP产品及服务介绍

3.11.3 ChipMOS在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

3.11.4 ChipMOS公司简介及主要业务

3.12 KYEC

3.12.1 KYEC公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

- 3.12.2 KYEC FC-CSP产品及服务介绍
- 3.12.3 KYEC在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
- 3.12.4 KYEC公司简介及主要业务
- 3.13 Unisem
 - 3.13.1 Unisem公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手
 - 3.13.2 Unisem FC-CSP产品及服务介绍
 - 3.13.3 Unisem在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
 - 3.13.4 Unisem公司简介及主要业务
- 3.14 Walton Advanced Engineering
 - 3.14.1 Walton Advanced Engineering公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手
 - 3.14.2 Walton Advanced Engineering FC-CSP产品及服务介绍
 - 3.14.3 Walton Advanced Engineering在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
 - 3.14.4 Walton Advanced Engineering公司简介及主要业务
- 3.15 Signetics
 - 3.15.1 Signetics公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手
 - 3.15.2 Signetics FC-CSP产品及服务介绍
 - 3.15.3 Signetics在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
 - 3.15.4 Signetics公司简介及主要业务
- 3.16 Hana Micron
 - 3.16.1 Hana Micron公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手
 - 3.16.2 Hana Micron FC-CSP产品及服务介绍
 - 3.16.3 Hana Micron在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
 - 3.16.4 Hana Micron公司简介及主要业务
- 3.17 NEPES
 - 3.17.1 NEPES公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手
 - 3.17.2 NEPES FC-CSP产品及服务介绍
 - 3.17.3 NEPES在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）
 - 3.17.4 NEPES公司简介及主要业务
- 4 中国不同产品类型FC-CSP规模及预测
 - 4.1 中国不同产品类型FC-CSP规模及市场份额（2020-2025）
 - 4.2 中国不同产品类型FC-CSP规模预测（2026-2031）
- 5 不同应用分析
 - 5.1 中国不同应用FC-CSP规模及市场份额（2020-2025）
 - 5.2 中国不同应用FC-CSP规模预测（2026-2031）
- 6 行业发展机遇和风险分析
 - 6.1 FC-CSP行业发展机遇及主要驱动因素
 - 6.2 FC-CSP行业发展面临的风险
 - 6.3 FC-CSP行业政策分析
 - 6.4 FC-CSP中国企业SWOT分析
- 7 行业供应链分析
 - 7.1 FC-CSP行业产业链简介
 - 7.1.1 FC-CSP行业供应链分析
 - 7.1.2 主要原材料及供应情况
 - 7.1.3 FC-CSP行业主要下游客户
 - 7.2 FC-CSP行业采购模式
 - 7.3 FC-CSP行业开发/生产模式
 - 7.4 FC-CSP行业销售模式
- 8 研究结果
- 9 研究方法 with 数据来源
 - 9.1 研究方法
 - 9.2 数据来源
 - 9.2.1 二手信息来源
 - 9.2.2 一手信息来源
 - 9.3 数据交互验证
 - 9.4 免责声明

表格目录

表 1: 中国市场不同产品类型FC-CSP规模（万元）及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）

表 2: 单芯片FC-CSP主要企业列表

表 3: 多芯片平置FC-CSP主要企业列表

表 4: 叠层芯片混联FC-CSP主要企业列表

表 5: 中国市场不同技术FC-CSP规模（万元）及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）

表 6: 凸块技术主要企业列表

表 7: 基板技术主要企业列表

表 8: 塑封技术主要企业列表

表 9: 中国市场不同工艺FC-CSP规模（万元）及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）

表 10: 焊锡凸块主要企业列表

表 11: 混合键合主要企业列表

表 12: 中国市场不同应用FC-CSP规模（万元）及增长率对比（2020 VS 2024 VS 2031）

表 13: 中国市场主要企业FC-CSP规模（万元）&（2020-2025）

表 14: 中国市场主要企业FC-CSP规模份额对比（2020-2025）

表 15: 中国市场主要企业总部及地区分布及主要市场区域

表 16: 中国市场主要企业进入FC-CSP市场日期

表 17: 中国市场主要厂商FC-CSP产品类型及应用

表 18: 2024年中国市场FC-CSP主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）

表 19: 中国市场FC-CSP市场投资、并购等现状分析

表 20: ASE Group公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 21: ASE Group FC-CSP产品及服务介绍

表 22: ASE Group在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 23: ASE Group公司简介及主要业务

表 24: Samsung公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 25: Samsung FC-CSP产品及服务介绍

表 26: Samsung在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 27: Samsung公司简介及主要业务

表 28: Amkor公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 29: Amkor FC-CSP产品及服务介绍

表 30: Amkor在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 31: Amkor公司简介及主要业务

表 32: JECT公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 33: JECT FC-CSP产品及服务介绍

表 34: JECT在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 35: JECT公司简介及主要业务

表 36: SPIL公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 37: SPIL FC-CSP产品及服务介绍

表 38: SPIL在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 39: SPIL公司简介及主要业务

表 40: Powertech Technology Inc公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 41: Powertech Technology Inc FC-CSP产品及服务介绍

表 42: Powertech Technology Inc在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 43: Powertech Technology Inc公司简介及主要业务

表 44: TSHT公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 45: TSHT FC-CSP产品及服务介绍

表 46: TSHT在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 47: TSHT公司简介及主要业务

表 48: TFME公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 49: TFME FC-CSP产品及服务介绍

表 50: TFME在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 51: TFME公司简介及主要业务

表 52: UTAC公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 53: UTAC FC-CSP产品及服务介绍

表 54: UTAC在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 55: UTAC公司简介及主要业务

表 56: Chipbond公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 57: Chipbond FC-CSP产品及服务介绍

表 58: Chipbond在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 59: Chipbond公司简介及主要业务

表 60: ChipMOS公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 61: ChipMOS FC-CSP产品及服务介绍

表 62: ChipMOS在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 63: ChipMOS公司简介及主要业务

表 64: KYEC公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 65: KYEC FC-CSP产品及服务介绍

表 66: KYEC在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 67: KYEC公司简介及主要业务

表 68: Unisem公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 69: Unisem FC-CSP产品及服务介绍

表 70: Unisem在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 71: Unisem公司简介及主要业务

表 72: Walton Advanced Engineering公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 73: Walton Advanced Engineering FC-CSP产品及服务介绍

表 74: Walton Advanced Engineering在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 75: Walton Advanced Engineering公司简介及主要业务

表 76: Signetics公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 77: Signetics FC-CSP产品及服务介绍

表 78: Signetics在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 79: Signetics公司简介及主要业务

表 80: Hana Micron公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 81: Hana Micron FC-CSP产品及服务介绍

表 82: Hana Micron在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 83: Hana Micron公司简介及主要业务

表 84: NEPES公司信息、总部、FC-CSP市场地位以及主要的竞争对手

表 85: NEPES FC-CSP产品及服务介绍

表 86: NEPES在中国市场FC-CSP收入（万元）及毛利率（2020-2025）

表 87: NEPES公司简介及主要业务

表 88: 中国不同产品类型FC-CSP规模列表（万元）&（2020-2025）

表 89: 中国不同产品类型FC-CSP规模市场份额列表（2020-2025）

表 90: 中国不同产品类型FC-CSP规模（万元）预测（2026-2031）

表 91: 中国不同产品类型FC-CSP规模市场份额预测（2026-2031）

表 92: 中国不同应用FC-CSP规模列表（万元）&（2020-2025）

表 93: 中国不同应用FC-CSP规模市场份额列表（2020-2025）

表 94: 中国不同应用FC-CSP规模（万元）预测（2026-2031）

表 95: 中国不同应用FC-CSP规模市场份额预测（2026-2031）

表 96: FC-CSP行业发展机遇及主要驱动因素

表 97: FC-CSP行业发展面临的风险

表 98: FC-CSP行业政策分析

表 99: FC-CSP行业供应链分析

表 100: FC-CSP上游原材料和主要供应商情况

表 101: FC-CSP行业主要下游客户

表 102: 研究范围

表 103: 本文分析师列表

图表目录

图 1: FC-CSP产品图片

图 2: 中国不同产品类型FC-CSP市场份额2024 & 2031

图 3: 单芯片FC-CSP产品图片

图 4: 中国单芯片FC-CSP规模（万元）及增长率（2020-2031）

图 5: 多芯片平置FC-CSP产品图片

图 6: 中国多芯片平置FC-CSP规模（万元）及增长率（2020-2031）

图 7: 叠层芯片混联FC-CSP产品图片

图 8: 中国叠层芯片混联FC-CSP规模（万元）及增长率（2020-2031）

图 9: 中国不同技术FC-CSP市场份额2024 & 2031

图 10: 凸块技术产品图片

图 11: 中国凸块技术规模 (万元) 及增长率 (2020-2031)
图 12: 基板技术产品图片
图 13: 中国基板技术规模 (万元) 及增长率 (2020-2031)
图 14: 塑封技术产品图片
图 15: 中国塑封技术规模 (万元) 及增长率 (2020-2031)
图 16: 中国不同工艺FC-CSP市场份额2024 & 2031
图 17: 焊锡凸块产品图片
图 18: 中国焊锡凸块规模 (万元) 及增长率 (2020-2031)
图 19: 混合键合产品图片
图 20: 中国混合键合规模 (万元) 及增长率 (2020-2031)
图 21: 中国不同应用FC-CSP市场份额2024 VS 2031
图 22: 移动设备AP
图 23: 基带芯片
图 24: 其他
图 25: 中国FC-CSP市场规模增速预测: (2020-2031) & (万元)
图 26: 中国市场FC-CSP市场规模, 2020 VS 2024 VS 2031 (万元)
图 27: 2024年中国市场前五大厂商FC-CSP市场份额
图 28: 2024年中国市场FC-CSP第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图 29: 中国不同产品类型FC-CSP市场份额2020 & 2024
图 30: FC-CSP中国企业SWOT分析
图 31: FC-CSP产业链
图 32: FC-CSP行业采购模式
图 33: FC-CSP行业开发/生产模式分析
图 34: FC-CSP行业销售模式分析
图 35: 关键采访目标
图 36: 自下而上及自上而下验证
图 37: 资料三角测定